

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于拟对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**合肥晶奕集成电路有限公司（以下简称“晶奕集成”或“标的公司”）

● **投资金额：**合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟通过股权转让及增资的方式，合计向其投资 20 亿元人民币并取得晶奕集成 100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施尚存在不确定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定性，可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易背景

晶奕集成是晶合集成四期项目的建设主体，本次投资完成后，晶奕集成将成为公司的全资子公司。晶合集成四期项目投资总额为 355 亿元，计划建设 12 英寸晶圆制造生产线，产能约 5.5 万片/月，重点布局 40 纳米及 28 纳米 CIS、OLED

及逻辑等工艺，产品可广泛应用于 OLED 显示面板、AI 手机、AI 电脑、智能汽车及人工智能等领域。

本次交易将增强晶奕集成资金实力，补充其经营发展中的营运资金需求。后续晶奕集成将根据项目建设进度及资金安排，做好资本金筹集工作，公司将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定及时履行信息披露义务。

2、本次交易基本情况

为进一步巩固和扩大在特色工艺制造领域的优势，公司拟以 0 元对价受让晶奕集成原股东合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企业管理有限公司持有晶奕集成的全部股权（认缴注册资本 0.2 亿元，实缴注册资本 0 元）。同时，公司拟认购晶奕集成新增注册资本 19.8 亿元，增资完成后，晶奕集成注册资本将由 0.2 亿元增加至 20 亿元。

通过上述股权转让及增资的方式，公司拟合计向晶奕集成投资 20 亿元人民币并取得晶奕集成 100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。

3、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：受让股权
投资标的名称	合肥晶奕集成电路有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>20 亿元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》规定，本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次交易标的公司的基本情况

（一）本次交易标的公司的概况

本次投资标的为晶奕集成的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”和“购买资产”。

（二）本次交易标的公司的具体信息

1、本次交易标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	合肥晶奕集成电路有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91340100MAEQGXMW56</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	王兴亚
成立日期	2025/07/17
注册资本	2,000 万元人民币
实缴资本	0 万元人民币
注册地址	安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区合肥综合保

	税区内西淝河路 88 号
主要办公地址	安徽省合肥市合肥新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
控股股东	合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
主营业务	一般项目：集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;电子专用材料研发;新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2、本次交易标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日，晶奕集成尚未开展经营活动，各股东实缴注册资本为 0 元，资产、负债各项目余额均为 0 元。

3、本次交易前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）	1,999.00	99.95	-	-
2	合肥晶策企业管理有限公司	1.00	0.05	-	-
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-	200,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00	200,000.00	100.00

4、本次交易标的相关权属情况

晶奕集成不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。晶奕集成不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

（三）出资方式及相关情况

本次交易的资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。

三、本次交易标的原有股东基本情况

（一）合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称	合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91340100MA8PTEH5XB</u> <input type="checkbox"/> 不适用
执行事务合伙人	合肥晶策企业管理有限公司
成立日期	2022/12/09
出资额	2,000.01 万元人民币
实缴资本	0 万元人民币
主要经营场所	合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
执行事务合伙人/委派代表	合肥晶策企业管理有限公司/曹宗野
与标的公司的关系	标的公司原有股东
主营业务	一般项目：企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）合肥晶策企业管理有限公司

法人/组织全称	合肥晶策企业管理有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91340100MA2UXCME5Y</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	曹宗野
成立日期	2020/06/18
注册资本	10 万元人民币
实缴资本	6 万元人民币
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
主要办公地址	合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
控股股东/实际控制人	曹宗野
与标的公司的关系	标的公司原有股东
主营业务	企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、交易标的定价原则、方法和依据及公平合理性分析

本次交易遵循公平自愿的商业原则，公司与各方协商一致同意，本次转让晶奕集成尚未实缴出资的股权的对价为 0 元，增资价格为按照注册资本平价增资，本次股权转让及增资遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让及增资协议的主要内容

（一）协议主体

投资者：合肥晶合集成电路股份有限公司

标的公司：合肥晶奕集成电路有限公司

标的公司现有股东：合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企业管理有限公司

（二）增资方案

1、股权转让：各方同意，根据本协议约定的条款和条件，标的公司现有股东拟将持有标的公司 100.00%的股权（认缴出资额 2,000.00 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 元转让给投资者。

2、本次增资：各方同意，根据本协议约定的条款和条件，投资者拟以货币方式共计出资 19.80 亿元认购标的公司新增注册资本 19.80 亿元。

3、本次股权转让及增资完成后，晶合集成将取得并持有标的公司 100.00%的股权，标的公司注册资本将变更为 20 亿元。

（三）协议生效条件

本协议经各方签字盖章后生效，本协议的任何修改须经各方共同签署书面文件。

（四）违约责任

本协议生效后，各方即应受本协议条款的约束，对任何条款的违反均构成违约，如给对方造成经济损失的，应足额进行赔偿。

六、本次交易对上市公司的影响

公司本次通过股权转让及增资的方式取得晶奕集成 100%股权，交易后标的公司纳入公司合并报表范围，符合公司战略布局及未来经营发展规划。本次交易助力公司优化产业结构，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。本次交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生重大不利影响。

七、本次交易的风险提示

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施尚存在不确定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定性，可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日